

6125 岡本工作機械製作所 19/3Q1 決算メモ 目標値引き上げアウトパフォーム（継続）

19/3 期ファイナルポリシヤー増産寄与し収益上方修正見通しで 20/3 期も高成長続く

株価 3720 円 (8/9) 時価総額 176 億円 (8/9) 発行済株 4718 千株 (8/9)

PER (19/3DO) (7.5X) PBR (1.45X) 配当 (19/3DO 予) 100 円 配当利回り : 2.7%

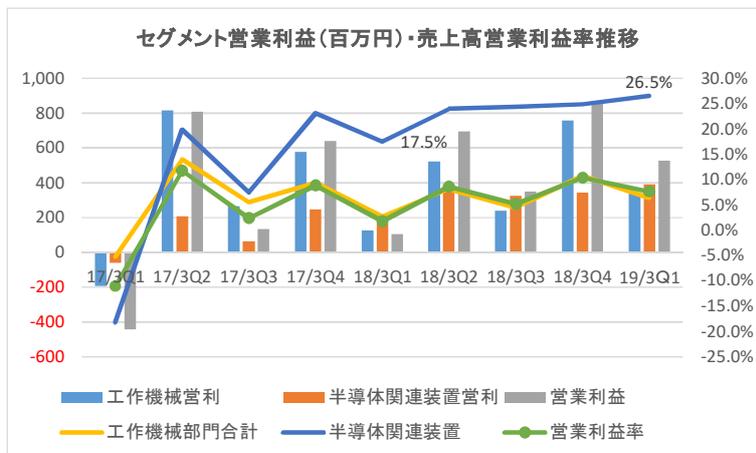
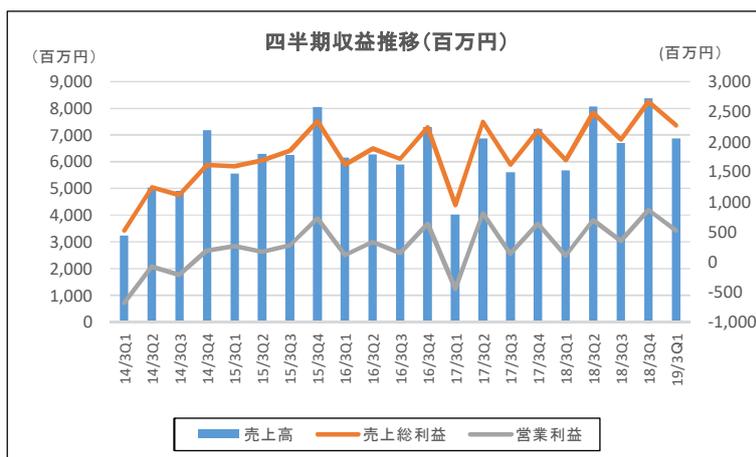
要約

- ・ 19/3Q1 は 21.1%増収、営利 5.1 倍、受注 78.2%増、受注残 3.0 倍と上伸続く
- ・ 19/3 期会社予想変更なく 11.0%増収、28.9%営業増益予想は上期から上方修正期待膨らむ
- ・ 20/3 期も中・韓・台 300mm ウエハ新設投資相次ぎファイナルポリシヤーで収益拡大続く
- ・ 次世代半導体製造技術実用化に向け「Si 貫通電極ウエハ全自動薄化加工装置」開発進む
- ・ 株価は 19/3 期 DO 予想 EPS497 円に対し東京エレクトロン並みの PER12 倍 5970 円目標

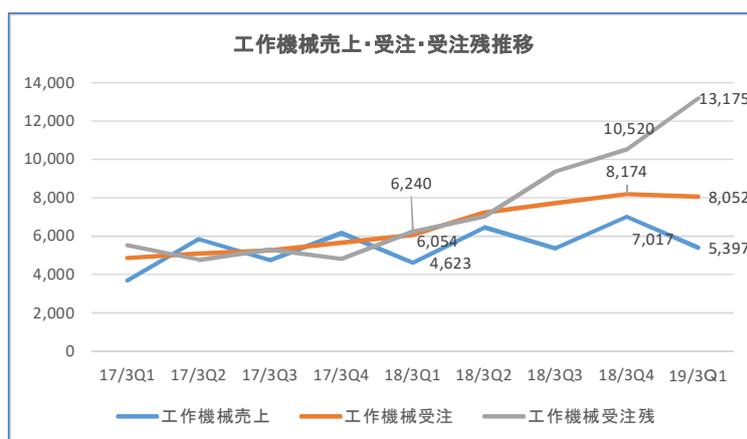
19/3Q1 は 21.1%増収、営利 5.1 倍、受注 78.2%増、受注残 3.0 倍と上伸続く

8/9 に 19/3Q1 が開示された。19/3Q1 は売上高 68.71 億円 (21.1%増)、営業利益 5.26 億円 (4.1 倍)、経常利益 4.50 億円 (6.6 倍)、税引利益 3.46 億円 (9.4 倍)、受注高 156.79 億円 (78.2%増)、受注残 295.85 億円 (3.0 倍) と上伸を続けた。

セグメント別では工作機械が売上高 53.97 億円 (16.7%増)、受注高 80.52 億円 (33.0%増)、営業利益 3.43 億円 (2.7 倍)、受注残 131.75 億円 (2.1 倍) となった。国内向けでは金型業界や工作機械業界向けに剛性の高い門型平面研削盤が伸びている。また半導体製造装置業界向けでは、帯電防止用に絶縁体のセラミックス精密部材が多用されるのに伴い平面研削盤に砥石を削る装置を付けた超精密加工ができる精密成形研削盤、さらにはウエハ製造装置用セラミックス



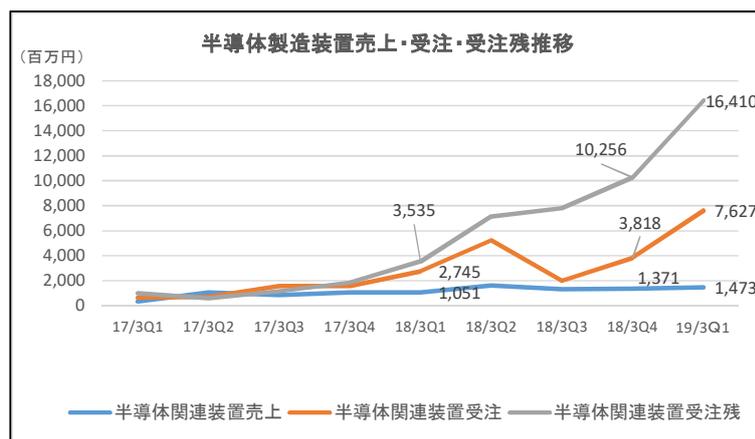
テーブルやセラミックス積層コンデンサなどの丸物ワークを研削するロータリー平面研削盤の伸長が続いている。海外向けでは欧州向けに汎用平面研削盤、大型研削盤が好調、アジア向けでも大型平面研削盤や直線運動用軸受け向けガイド案内面研削盤等が好調に推移



した。なお、工作機械セグメントにはファナック向けのロボット変減速機向け精密歯車、鋳物の売上も含まれており、工作機械だけを取り出すと、伸び率はさらに高いとみられる（部門の細分開示は半期のみ）。

半導体関連装置セグメントは売上高 14.73 億円 (28.1%増)、受注高 76.27 億円 (2.8 倍)、

営業利益 3.91 億円 (2.1 倍)、受注残 164.10 億円 (4.6 倍) となり、売上高営業利益率が 26.5% (9.0 ポイントアップ) まで高まった。国内向けでは MLCC 基板加工やパワー半導体などの脆性材用バックグラインダーやスライサー、300mm ウエハ用ファイナルポリシ



ャーが好調を持続、海外向けも中国中心にファイナルポリシャー、デバイス用バックグラインダーの伸長が続いている。

全体を通じて、世界シェア 80%程度と推測される高付加価値の 300mm ウエハ用ファイナルポリシャー、寡占状況にある脆弱性のセラミックス、パワーデバイス等加工の工作機械、半導体関連装置などの比率が高まり、収益上伸となった模様。なお、受注残高が膨らんでいるが、ファイナルポリシャーにおいては納期が 2020 年以降となるものも含まれるとみられる。

**19/3 期会社予想変更なく 11.0%増収、28.9%営業増益予想は上期から上方修正期待膨らむ**

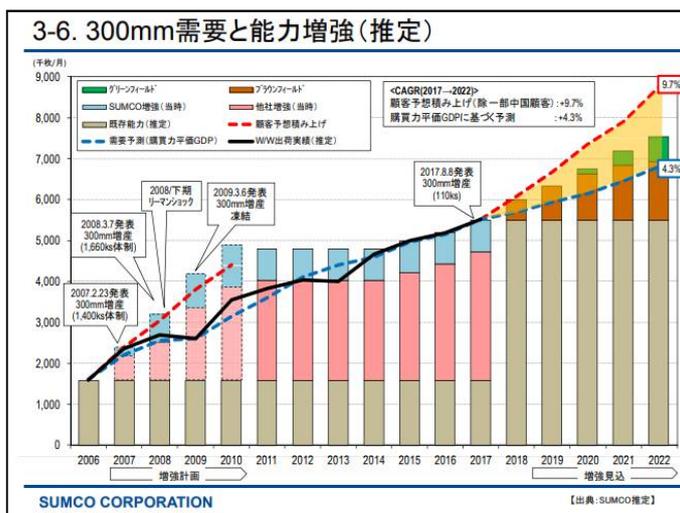
Q1 の好調を受けても、19/3 期会社予想は変更されず、売上高 320 億円 (11.0%増)、営業利益 26 億円 (28.9%増)、経常利益 23.5 億円、税引利益 16.5 億円 (16.8%減、前期の法人税還付前比較 18.9%増)、受注高 380 億円 (11.5%減)、配当 80 円予想としている。これ

は従来の中期経営計画を配当以外踏襲した数字で、上下期比較も売上は均等割りで、上期売上高 160 億円 (16.4%増)、営利 11 億円 (37.9%増)、下期売上高 160 億円 (6.0%増)、営利 15 億円 (23.0%増) 予想としている。下期の利益率が高いのは 4Q 年度末に合わせ収益性の高い製品が売上となる傾向と、高採算の半導体関連売上が継続的に拡大するため。但し Q1 の数字を差し引いた Q2 予想は売上高 91.29 億円 (前年同期比 13.2%増、Q1 比 32.9%増) ながら営業利益は 5.74 億円 (同 17.3%減、Q1 比 9.1%増)、経常利益 5.00 億円 (同 20.3%減、Q1 比 11.1%増)、税引利益 4.04 億円 (同 15.3%減、Q1 比 16.8%増) 予想となり、Q1 の受注状況、高付加価値製品の売上高比率向上見通しから、前年同期比減益見通しは現実味がなく、上期より大幅な利益増額修正が見込まれる。

期初会社予想の部門別では工作機械セグメントが売上高 240 億円 (2.3%増)、受注額 270 億円 (7.4%減)、半導体関連セグメントが売上高 80 億円 (48.9%増)、受注高 110 億円 (20.2%減) 予想で、受注は 18/3 期受注の反動を前提としている。しかし Q1 での受注額進捗状況は既に 41.3%に達し、特に半導体関連では 69%の進捗率となっている。Q2 以降についても、工作機械業界の受注好調、半導体製造装置メーカーの設備増強、300mm ウエハの継続的な増産計画、EV 増強などを睨んだ精密金型製作設備投資増などが見込まれ、同社の受注環境は米中摩擦の影響をほとんど受けない形で拡大が見込まれる。また海外生産化に拍車をかけている平面研削盤も今期はモノづくり補助金効果から国内汎用平面研削盤も伸びが見込める。このため、両セグメントとも会社予想を上回る受注が期待されるとともに、収益率もアップし、収益の大幅な増額修正が期待される。

### 20/3 期も中・韓・台 300mm ウエハ新設投資相次ぎファイナルポリシャで収益拡大続く

同社の 300mm ウエハ用ファイナルポリシャは、業界 5 位の独シルトロン (ラップマスター傘下のピーターウォルターズが独占供給) を除き、シリコンウエハメーカー各社に納入され、世界シェアは 80%程度と推測される。現在、日系 2 社が継続的な能力増強を図っているほか、世界 3 位の台湾グローバルウェハズが新潟での増産に加え 480 億円を投入し韓国でサムソン、ハイニックス向けに供給する計画が浮上、LG グループから SK グループに買収された第 4 位の SK シルトロンも投資再開の意向の他、ダイフクの決算説明会で中国企業から 300mm ウエハ製造向け搬送装置発注を獲得したとの説明があり、いよいよ国産化投資が加速する状況にある。このため納期が 2 年超でも引き合いが



増えている模様で、ファイナルポリッシャー受注拡大が少なくとも数年は拡大が続く見通し。またパワー半導体、MLCCの拡大も追い風で、ほぼ独占供給している脆弱性のある化合物半導体向けポリシング装置、さらにはバックグラインディング装置、ラッピング装置などの継続的な拡大も見込める。現状半導体関連装置はフル生産状況で、工作機械生産を大型特殊工作機械以外は海外生産に移管し、国内は半導体関連装置の生産拡大に注力し対応する計画。19/3期能力増として70%増、売上高90億円目指し、海外もシンガポール工場でバックグラインディング装置、ラッピング装置などファイナルポリッシャー以外の半導体関連装置増産が加速し、納期対応が進もう。



セラミックス加工向けロータリー平面研削盤「PRG-DXNCシリーズ」



セラミックス製のワーク

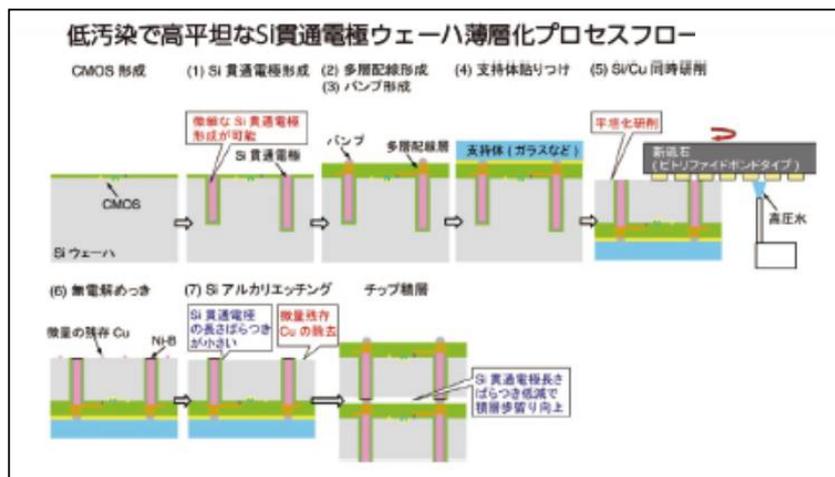
給している脆弱性のある化合物半導体向けポリシング装置、さらにはバックグラインディング装置、ラッピング装置などの継続的な拡大も見込める。現状半導体関連装置はフル生産状況で、工作機械生産を大型特殊工作機械以外は海外生産に移管し、国内は半導体関連装置の生産拡大に注力し対応する計画。19/3期能力増として70%増、売上高90億円目指し、海外もシンガポール工場でバックグラインディング装置、ラッピング装置などファイナルポリッシャー以外の半導体関連装置増産が加速し、納期対応が進もう。

工作機械部門は精密加工ニーズの高まり、セラミックスやガラス繊維複合材、さらには炭素繊維複合材など、非金属の研磨需要の更なる拡大が見込める。さらに歯車事業もファナック向け中心に拡大が見込まれ、車載変速用も多段化ニーズが高く堅調に伸び、収益拡大が続く見通し。このため全体収益も順調な拡大が見込め、中計予想を大きく上回る収益拡大が続こう。

### 次世代半導体製造技術実用化に向け「Si貫通電極ウエハ全自動薄化加工装置」開発進む

「Si貫通電極ウエハ全自動薄化加工装置」の実用化が進みつつある。アプリシアテクノロジー株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所と共同で開発したもので、2017年12月にマイルストーン1、現在マイルストーン2にあり実用機開発が具体化している。マイルストーン3を経て2020年に実用化の方向。同技術は高信頼性で低コスト、超高速、小型かつ薄い

3次元集積回路の実現に向け、Si貫通電極(TSV)ウエハの超平坦・低汚染の薄層化要素技術を開発した。Si貫通電極(TSV)ウエハを高平坦かつ高均一に10μm厚さレベルまで薄層化する加工技術で、TSVウエハ全自動薄化加工装置



を世界で初めて実用化するもの。この技術の実現でパッケージオンパッケージからSIP化

が進展、100台以上の薄化装置需要を見込む。また多くの電子製品に適用できる為、数兆円規模の潜在市場がある。同社では販売開始後5年で60億円の販売を見込んでいるが、具体化となれば20/3期以降、改めて半導体関連装置受注が拡大し、新たな成長が見込める。

### 株価は19/3期DO予想EPS497円に対し東京エレクトロン並みのPER12倍5970円目標

株価は半導体製造装置関連メーカーの株価調整の影響もあって下落し、4/20の大幅増額修正を受けて株価が急反発し、5/23に4840円まで上昇した。しかし改めて米中関税摩擦などの話題で半導体製造装置株、工作機械関連株が弱含み、その後回復過程にあるものの、現状は19/3期会社予想EPS373円に対してPER10倍水準と東京エレクトロンのコンセンサス予想EPSを基にしたPER12倍と比較して多少割安水準にある。しかも19/3期会社予想は従来中計予想を踏襲したにすぎず上期から大幅増額修正が期待され、当面の目標株価は19/3期DO予想EPS497.5円に対し、東京エレクトロン並みのPER12倍にあたる5970円と従来比1000円引き下げた目標を再度元に戻した目標とする。なお高シェア製品のウエイトが高く、300mmウエハ増産の継続的な拡大、さらには次世代製造装置の実用化で、潜在市場の大きさが認知されれば、持続的高成長企業として1部上場指定替えも視野に20/3期DO予想EPS667円に対し、1部機械平均PER16.3倍（7月末現在）の10900円、1万円大台越えもあり得る。

■ 岡本工作機械(6125)	(百万円、円)									
	売上高	増減率	営業利益	増減率	経常利益	増減率	税引利益	増減率	EPS	配当
17/3期	23,749	-7.3%	1,139	-7.1%	768	-20.9%	577	2.9%	130.40	40.00
18/3Q1	5,675	40.9%	103	黒転	68	黒転	37	黒転	8.50	0.00
18/3Q2	8,067	17.2%	694	-14.3%	627	-7.2%	477	-32.7%	107.70	20.00
18/3Q3	6,698	19.5%	349	158.5%	248	222.1%	257	104.0%	58.14	0.00
18/4Q4	8,387	16.0%	871	36.5%	764	37.4%	1,212	118.0%	273.90	50.00
18/3H1	13,742	26.0%	797	117.8%	695	414.8%	514	206.0%	116.20	20.00
18/3H2	15,085	17.5%	1,220	57.8%	1,012	82.0%	1,469	115.4%	332.04	70.00
18/3期	28,827	21.4%	2,017	77.0%	1,707	122.2%	1,983	243.5%	448.24	70.00
19/3Q1	6,871	21.1%	526	409.1%	450	557.8%	346	823.1%	82.27	0.00
19/3Q2会予(8/9)	9,129	13.2%	574	-17.3%	500	-20.3%	404	-15.3%	87.33	40.00
19/3H1会予	16,000	16.4%	1,100	37.9%	950	36.5%	750	45.9%	169.60	40.00
19/3H2会予	16,000	6.1%	1,500	23.0%	1,400	38.3%	900	-38.7%	203.53	40.00
19/3期会予	32,000	11.0%	2,600	28.9%	2,350	37.7%	1,650	-16.8%	373.13	80.00
19/3Q2DO予	9,429	16.9%	724	4.3%	700	11.6%	554	16.1%	121.26	40.00
19/3Q3DO予	8,500	26.9%	750	114.9%	750	202.4%	580	125.7%	131.16	0.00
19/3Q4DO予	10,200	21.6%	1,100	26.3%	850	11.3%	720	-40.6%	162.81	60.00
19/3H1DO予	16,300	18.6%	1,250	56.8%	1,150	65.5%	900	75.1%	203.53	40.00
19/3H2DO予	18,700	24.0%	1,850	51.6%	1,600	58.1%	1,300	-11.5%	293.97	60.00
19/3期DO予	35,000	21.4%	3,100	53.7%	2,750	61.1%	2,200	10.9%	497.50	100.00
20/3期DO予	44,000	25.7%	4,100	32.3%	3,850	40.0%	2,950	34.1%	667.10	130.00

四半期	17/3Q1	17/3Q2	17/3Q3	17/3Q4	18/3Q1	18/3Q2	18/3Q3	18/3Q4	19/3Q1	19/3Q2DO	19/3Q3DO	19/3Q4DO
売上高	4,027	6,882	5,607	7,233	5,675	8,067	6,698	8,387	6,871	9,429	8,500	10,200
売上原価	3,080	4,550	3,990	5,044	3,979	5,588	4,663	5,725	4,600	6,650	5,650	7,200
売上総利益	947	2,331	1,618	2,189	1,696	2,479	2,035	2,662	2,271	2,779	2,850	3,000
販管費	1,392	1,520	1,483	1,550	1,593	1,784	1,687	1,790	1,745	2,055	2,000	2,000
営業利益	-444	810	135	638	103	694	349	871	526	724	850	1,000
経常利益	-541	676	77	556	68	627	248	764	450	700	750	950
親株主帰属純利益	-573	636	96	418	37	477	257	1,212	346	554	580	720
四半期セグメント売上情報	17/3Q1	17/3Q2	17/3Q3	17/3Q4	18/3Q1	18/3Q2	18/3Q3	18/3Q4	19/3Q1	19/3Q2DO	19/3Q3DO	19/3Q4DO
工作機械売上	3,693	5,842	4,747	6,165	4,623	6,446	5,367	7,017	5,397	7,603	6,100	7,400
半導体関連装置売上	334	1,040	859	1,068	1,051	1,622	1,330	1,371	1,473	1,827	2,600	2,600
工作機械	2,200	4,286	3,047	4,344	2,600	4,438	3,212	4,858		5,253	3,500	4,900
商車	1,000	977	1,100	1,215	1,200	1,386	1,400	1,429		1,600	1,700	1,700
鋳物	600	472	600	607	700	745	755	730		750	900	800
合計	4,027	6,882	5,607	7,233	5,675	8,067	6,698	8,387	6,870	9,430	8,700	10,000
四半期セグメント営業利益	17/3Q1	17/3Q2	17/3Q3	17/3Q4	18/3Q1	18/3Q2	18/3Q3	18/3Q4	19/3Q1	19/3Q2DO	19/3Q3DO	19/3Q4DO
工作機械営業利	-193	816	265	577	126	524	240	756	343	587	380	590
半導体関連装置営業利	-61	207	64	247	184	389	324	341	391	479	680	700
部門合計営業利益	-254	1,023	329	824	310	930	547	1,097	734	1,066	1,060	1,290
調整額	-189	-214	-194	-186	-207	-219	-216	-225	-208	-216	-310	-290
営業利益	-444	810	135	638	103	694	349	871	526	724	850	1,000

年度	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
売上高	26,099	30,168	36,420	<b>36,632</b>	26,592	12,934	18,248	24,151	20,041	20,344	26,149	25,625	23,749	28,827	<b>32,000</b>	<b>35,000</b>	44,000
売上原価	18,149	21,825	25,838	25,726	19,881	11,150	13,750	18,421	15,198	15,849	18,690	18,168	16,664	19,955	<b>21,900</b>	<b>24,100</b>	30,800
売上総利益	7,949	8,342	10,581	10,906	6,710	1,783	4,498	5,729	4,843	4,495	7,459	7,457	7,085	8,872	<b>10,100</b>	<b>10,900</b>	13,200
販管費	4,160	4,557	5,367	6,321	5,604	4,115	4,966	4,955	4,535	5,271	6,027	6,230	5,945	6,854	<b>7,500</b>	<b>7,800</b>	9,100
営業利益	3,789	3,785	<b>5,214</b>	4,585	1,105	-2,331	-467	774	308	-776	1,431	1,226	1,139	2,017	<b>2,600</b>	<b>3,100</b>	4,100
営業外収益	115	270	347	176	119	150	402	72	351	266	106	156	115	94	0	0	0
営業外費用	503	452	585	678	885	461	604	575	425	416	502	411	496	404	0	0	0
経常利益	3,401	3,603	<b>4,976</b>	4,082	339	-2,642	-670	271	235	-925	1,035	971	768	1,707	<b>2,350</b>	<b>2,850</b>	3,850
親株主帰属純利益	2,857	2,102	<b>3,151</b>	2,567	-82	-2,709	-644	84	234	-1,323	1,040	561	577	1,983	<b>1,650</b>	<b>2,200</b>	2,950

セグメント売上情報年度	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
工作機械売上	16,045	18,323	20,977	23,073	17,473	7,959	13,981	19,128	17,396	17,978	22,807	22,488	20,447	<b>23,458</b>	<b>24,000</b>	<b>25,500</b>	31,000
半導体装置売上	10,055	11,845	<b>15,442</b>	13,558	9,118	4,975	4,266	5,023	2,644	2,366	3,341	3,136	3,301	5,374	<b>8,000</b>	<b>8,500</b>	13,000
工作機械								11,681	11,967	14,381	15,652	13,877	15,108	<b>16,000</b>	<b>16,700</b>	20,400	
半導体								3,244	3,704	4,760	4,247	4,292	5,415	<b>5,500</b>	<b>6,600</b>	7,600	
雑物								2,472	2,307	3,732	2,590	2,279	2,930	<b>2,500</b>	<b>3,200</b>	3,000	
合計	26,100	30,168	36,420	36,632	26,591	12,934	18,247	24,151	20,041	20,344	26,149	25,625	23,749	<b>32,000</b>	<b>35,000</b>	44,000	

セグメント営業利益	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
工作機械営業利益	2,948	3,507	<b>3,581</b>	2,789	911	-2,258	471	1,476	968	97	1,571	1,653	1,465	1,646	<b>1,900</b>	<b>2,050</b>	3,300
半導体装置営業利益	1,378	927	2,342	<b>2,008</b>	1,178	648	-224	72	48	-262	584	365	457	1,238	<b>2,250</b>	<b>2,500</b>	3,200
合計	4,326	4,434	<b>5,923</b>	4,797	2,089	-1,610	247	1,548	1,016	-165	2,155	2,018	1,922	2,884	<b>4,150</b>	<b>4,550</b>	6,500
調整額	-537	-649	-709	-812	-984	-721	-714	-774	-708	-611	-724	-793	-783	-867	<b>-1,050</b>	<b>-1,250</b>	-1,250
営業利益	3,789	3,785	<b>5,214</b>	4,585	1,105	-2,331	-467	774	308	-776	1,431	1,226	1,139	2,017	<b>2,600</b>	<b>3,100</b>	4,100

セグメント受注	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
工作機械受注	18,861	20,634	22,049	21,166	12,831	7,160	15,988	18,859	16,548	18,611	23,944	21,126	20,914	<b>29,164</b>	<b>27,000</b>	<b>30,000</b>	29,500
半導体装置受注	8,794	<b>17,684</b>	12,516	10,934	6,751	5,589	3,898	4,291	2,243	3,139	2,895	3,283	4,453	13,788	<b>11,000</b>	<b>17,000</b>	13,500
工作機械									0	0	0	0	14,343	20,777	<b>19,000</b>	<b>20,200</b>	19,100
半導体									0	0	0	0	4,292	5,415	<b>5,500</b>	<b>6,600</b>	7,900
雑物									0	0	0	0	2,279	2,972	<b>2,500</b>	<b>3,200</b>	2,500
受注合計	27,655	30,168	34,566	32,100	19,583	12,750	19,886	23,150	18,792	21,750	26,840	24,410	25,367	<b>42,962</b>	<b>38,000</b>	<b>47,000</b>	43,000

セグメント受注残	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
工作機械受注残	6,832	9,141	10,213	8,306	3,664	2,866	4,872	4,602	3,754	4,567	5,705	4,343	4,809	<b>10,520</b>	<b>13,520</b>	<b>17,020</b>	15,520
半導体装置受注残	3,182	9,021	6,095	3,470	1,103	1,718	1,349	617	216	989	543	690	1,842	<b>10,256</b>	<b>13,256</b>	<b>21,756</b>	22,256
受注残合計	10,014	18,162	16,308	11,776	4,768	4,584	6,222	5,220	3,971	5,557	6,249	5,034	6,651	<b>20,777</b>	<b>26,776</b>	<b>38,776</b>	37,776

年度	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
売上高	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
売上原価	69.5%	72.3%	70.9%	70.2%	74.8%	86.2%	75.4%	76.3%	75.8%	77.9%	71.5%	70.9%	70.2%	68.4%	68.9%	70.0%	70.0%
売上総利益	30.5%	27.7%	29.1%	29.8%	25.2%	13.8%	24.6%	23.7%	24.2%	22.1%	28.5%	29.1%	29.8%	30.8%	31.6%	31.1%	30.0%
販管費	15.9%	15.1%	14.7%	17.3%	21.1%	31.8%	27.2%	20.5%	22.6%	25.9%	23.0%	24.3%	25.0%	23.8%	23.4%	22.3%	20.7%
営業利益	14.5%	12.5%	14.3%	12.5%	4.2%	-18.0%	-2.6%	3.2%	1.5%	-3.8%	5.5%	4.8%	4.8%	7.0%	8.1%	8.9%	9.3%
経常利益	13.0%	11.9%	13.7%	11.1%	1.3%	-20.4%	-3.7%	1.1%	1.2%	-4.5%	4.0%	3.8%	3.2%	5.9%	7.3%	8.1%	8.8%
親株主帰属純利益	10.9%	7.9%	8.7%	7.0%	-0.3%	-20.9%	-3.5%	0.3%	1.2%	-6.5%	4.0%	2.2%	2.4%	6.9%	5.2%	6.3%	6.7%

セグメント営業利益率	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 会予	19/3期 DO予	20/3期 DO予
工作機械営業利益	18.4%	19.1%	17.1%	12.1%	5.2%	-28.4%	3.4%	7.7%	5.6%	0.5%	6.9%	7.4%	7.2%	7.0%	<b>7.2%</b>	<b>7.2%</b>	6.6%
半導体装置営業利益	13.7%	7.8%	15.2%	19.2%	12.9%	13.0%	-5.3%	1.4%	1.8%	-11.1%	17.5%	11.6%	13.8%	23.0%	<b>26.5%</b>	<b>25.4%</b>	25.4%
合計	16.6%	14.7%	16.3%	14.7%	7.9%	-12.4%	1.4%	6.4%	5.1%	-0.8%	8.2%	7.9%	8.1%	10.0%	<b>11.9%</b>	<b>12.2%</b>	12.2%
調整額	-2.1%	-2.2%	-1.9%	-2.2%	-3.7%	-5.6%	-3.9%	-3.2%	-3.5%	-3.0%	-2.8%	-3.1%	-3.3%	-3.0%	<b>-3.0%</b>	<b>-2.8%</b>	-2.8%
営業利益	14.5%	12.5%	14.3%	12.5%	4.2%	-18.0%	-2.6%	3.2%	1.5%	-3.8%	5.5%	4.8%	4.8%	7.0%	<b>8.1%</b>	<b>8.9%</b>	9.3%

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS,LTD.

2018/8/9

